

# Axion® T2000

高分辨率 CD-SAXS 量测系统可为复杂、高宽比的三维立体堆叠结构存储器（3D NAND）和动态随机存储器（DRAM）提供快速、精确、无损的三维（3D）形状测量。

## 好处：

Axion® T2000 利用创新的 X 射线技术来识别可能影响存储器件功能或性能的细微结构变化。通过提供高分辨率、无损的三维 (3D) 外形测量，Axion T2000 帮助先进存储器制造商：

- 在研发过程中获得快速的学习周期，从而减少对长周期、破坏性测量方法（如 FIB-SEM、TEM 和横截面 SEM）的依赖
- 通过对新的工艺、设计节点和器件进行快速准确的表征和优化，加快产能爬坡。
- 在线监控关键的工艺步骤，以确保在大批量生产过程中识别并快速解决影响器件质量的变化。

## 技术：

- 无损式 CD-SAXS 测量技术
- 高通量 X 射线源
- 最大衍射级分离
- 高分辨率探测器
- 采用拥有市场领先的 AOI（入射角）动态范围的精确移动控制样品台
- AcuShape® 建模

## 应用：

- 工艺表征和优化
- 工程分析
- 在线工艺监控
- 蚀刻工艺机台监控
- PM（预防性维护）后蚀刻工艺机台鉴定



## 市场：

芯片制造

先进设计节点的存储器件，包括三维立体堆叠结构的存储器 (3D NAND) 和动态随机存储器 (DRAM)

## 平台：

- 可定制配置
- 扩展性
- 300 毫米晶圆

## 更多信息：

[www.kla.com/zh-hans/products/chip-manufacturing/metrology#axion](http://www.kla.com/zh-hans/products/chip-manufacturing/metrology#axion)